

FPC薄型化により 狭スペース組付けに有効！

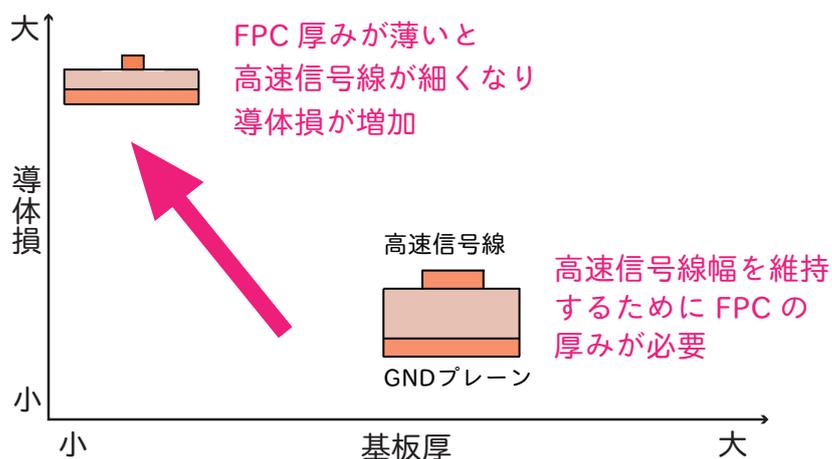
低スプリングバック、高屈曲性が要求される箇所

製品特徴

- マイクロストリップラインの課題である、FPCの厚みと導体損の関係を解消させる現在研究開発中の技術です。
- グラウンド(GND)プレーンにスリットデザインを設けることにより伝送特性を維持したまま、FPCの薄型化実現が期待できます。

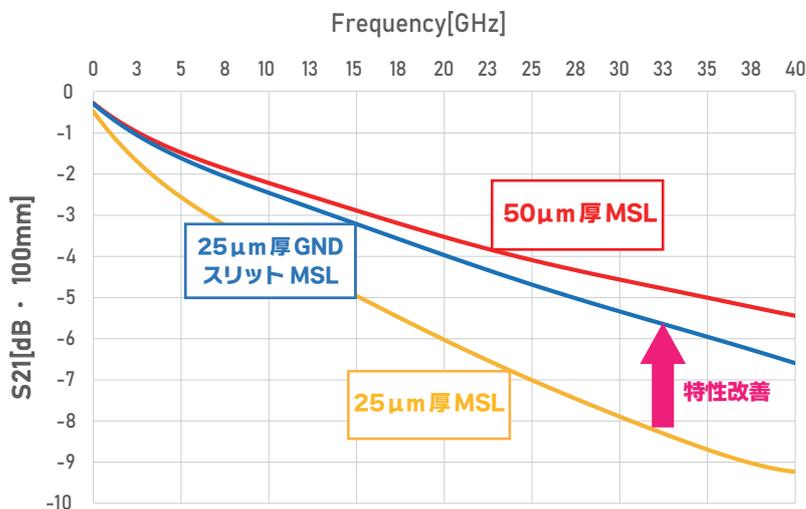
マイクロストリップライン (MSL) 構造の課題

従来のマイクロストリップラインの構造ではFPCの厚みを薄くすると高速信号線幅が細くなり、導体損が大きくなるため、伝送特性を維持したまま薄型化にすることが困難



伝送特性(S21測定)

伝送特性を維持したまま薄型化の実現が可能！



スリット構造例

